

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2025年4月24日(24.04.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/084363 A1

(51) 国際特許分類:

C09J 7/35 (2018.01) H01L 21/52 (2006.01)  
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)  
C09J 163/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/037040

(22) 国際出願日: 2024年10月17日(17.10.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2023-180985 2023年10月20日(20.10.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).

(72) 発明者: 細野 慶太 (HOSONO Keita); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社 レゾナック内 (JP). 金子 知世 (KANEKO

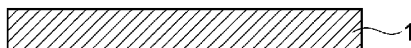
Tomoyo); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社 レゾナック内 (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: FILM-TYPE ADHESIVE AGENT, DICING/DIE BONDING INTEGRAL FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、ダイシング・ダイボンディングー体型フィルム、並びに半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a film-type adhesive agent which contains an epoxy resin, a phenolic resin, and an elastomer, and which may further contain an inorganic filler. The content of the inorganic filler is 0-10 mass% with respect to the whole mass of the film-type adhesive agent. The content of the elastomer is 20-50 mass% with respect to the whole mass of the film-type adhesive. The content of the elastomer is 40-60 parts by mass with respect to the total amount, i.e., 100 parts by mass, of the epoxy resin and the phenol resin.

(57) 要約: エポキシ樹脂と、フェノール樹脂と、エラストマーとを含有し、無機フィラーをさらに含有していてもよい、フィルム状接着剤が開示される。無機フィラーの含有量は、フィルム状接着剤の全量を基準として、0~10質量%である。エラストマーの含有量は、フィルム状接着剤の全量を基準として、20~50質量%である。エラストマーの含有量は、エポキシ樹脂及びフェノール樹脂の総量100質量部に対して、40~60質量部である。

WO 2025/084363 A1

[続葉有]

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))